



Ferrotec Holdings Corporation

株式会社フェローテックホールディングス

2023年3月期 決算説明

2023.5.31(水)

1. 当期連結決算においては、連結子会社は2022年1月～2022年12月末の業績を連結しております。
2. 本資料は、2023年3月期決算の業績に関する情報の提供を目的としたものであり、当社株式の購入や売却等を勧誘するものではありません。投資に関する決定は、利用者ご自身のご判断において行われるようお願いいたします。
3. 本資料は開示日現在のデータに基づいて作成されております。本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点の当社の判断であり予告なしに変更されることがあります。

連結決算サマリー

(百万円)	2022年3月期		2023年3月期		前期比	
	金額	金額	金額	金額	増減率(%)	
売上高	133,821	210,810	76,989	57.5	売上高2.108億円、前期比+58%	
売上原価	85,143	138,728	53,585	62.9	✓ 半導体等装置関連、電子デバイス事業とも大幅増収	
売上総利益	48,677	72,081	23,404	48.1	✓ 過去最高売上を更新	
販売管理費	26,076	37,038	10,962	42.0		
営業利益	22,600	35,042	12,442	55.1	営業利益350億円、前期比+55%	
営業外収益	4,636	9,872	5,236	112.9	経常利益424億円、前期比+63%	
営業外費用	1,243	2,466	1,223	98.4	✓ 売上拡大・利益増加、過去最高益を更新	
経常利益	25,994	42,448	16,454	63.3	✓ 営業外収益99億円が経常利益を押し上げ ・為替差益 : 55億円 ・補助金収入: 26億円	
特別利益	9,421	856	△ 8,565	△ 90.9	当期純利益297億円、前期比+11%	
特別損失	1,767	1,263	△ 504	△ 28.5	✓ 前期の持分変動利益93億円(中国ウエーハ会社の第三者割当増資による)の発生なし	
非支配株主に帰属する当期純損益	1,254	4,585	3,331	265.6	✓ 今期特別損失13億円の内、7億円は段階取得による差損(大泉製作所TOBIによる)	
親会社株主に帰属する当期純利益	26,659	29,702	3,043	11.4	✓ 非支配株主持分利益	
投資額*	35,378	62,661	27,283	77.1	<ul style="list-style-type: none"> ・シリコンパーツ・石英坩堝事業 21億円 ・パワー半導体事業 22億円 ・洗浄事業 6億円 	
減価償却費	8,085	12,618	4,533	56.1		

注 為替レート2022/3月期→2023/3月期: 米ドル 110.37円→132.08円 人民元 17.12円→19.50円(期中平均レート)
投資額=有形資産、無形固定資産、有価証券の取得等の合計

セグメント別売上高および営業利益

売上高 (単位:百万円)	2022年3月期		2023年3月期		前期比	
	金額	売上比(%)	金額	売上比(%)	増減額	増減率(%)
半 導 体 等 装 置 関 連	90,280	67.3	132,194	62.7	41,914	46.4
電 子 デ バ イ ス	27,023	20.2	53,024	25.2	26,001	96.2
そ の 他	16,517	12.3	25,590	12.1	9,073	54.9
合 計	133,821	100.0	210,810	100.0	76,989	57.5

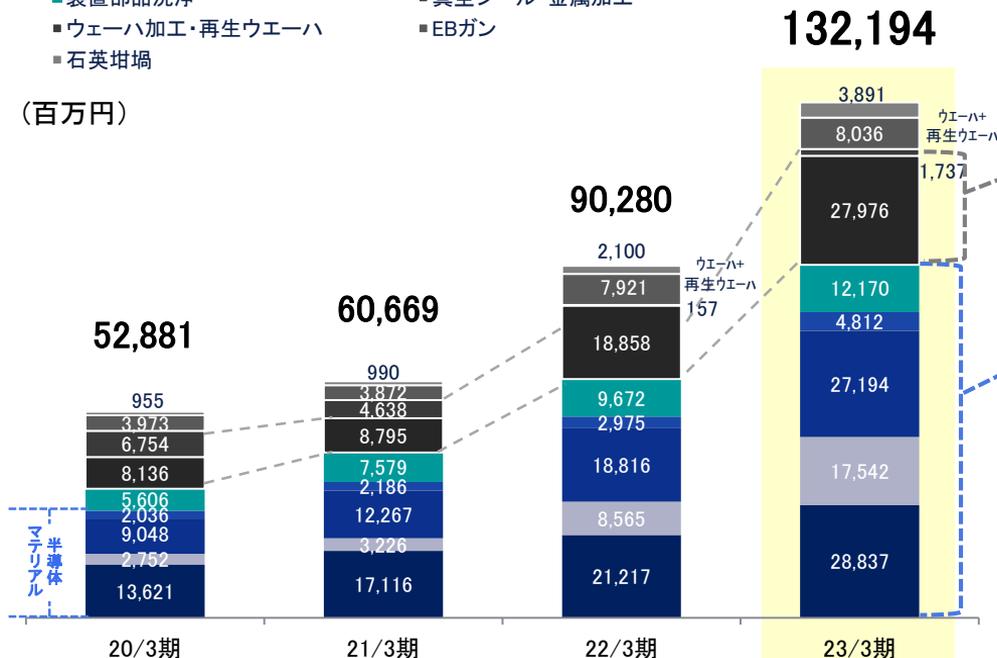
営業利益 (単位:百万円)	2022年3月期		2023年3月期		前期比	
	金額	利益率(%)	金額	利益率(%)	増減額	増減率(%)
半 導 体 等 装 置 関 連	15,804	17.5	24,090	18.2	8,286	52.4
電 子 デ バ イ ス	6,689	24.8	11,178	21.1	4,489	67.1
そ の 他	398	2.4	597	2.3	199	50.0
全 社 消 去	△291	-	△824	-	△ 533	-
合 計	22,600	16.9	35,042	16.6	12,442	55.1

(百万円)	2022/3期	2023/3期	前期比 (%)
半 導 体 等 装 置 関 連	90,280	132,194	46.4
真空シール・金属加工	18,858	27,976	48.4
石英製品	21,217	28,837	35.9
シリコンパーツ	8,565	17,542	104.8
セラミックス	18,816	27,194	44.5
CVD-SiC	2,975	4,812	61.7
EBガン・LED蒸着装置	7,921	8,036	1.5
ウエーハ加工(連結対象のみ)	59	236	300.0
再生ウエーハ	98	1,501	1,431.6
装置部品洗浄	9,672	12,170	25.8
石英坩堝	2,100	3,891	85.3
電 子 デ バ イ ス	27,023	53,024	96.2
サーモジュール	17,635	23,266	31.9
パワー半導体基板	8,473	20,011	136.2
磁性流体・その他	916	936	2.2
New → センサ	-	8,811	-
そ の 他	16,518	25,590	54.9
合 計	133,821	210,810	54.9

売上高の推移

- 石英
- セラミックス
- 装置部品洗浄
- ウェーハ加工・再生ウェーハ
- 石英坩堝
- シリコンパーツ
- CVD-SiC
- 真空シール・金属加工
- EBガン

(百万円)



セグメント総括

- ・真空シール・金属加工、半導体材料製品とも大幅増収
- 真空シール・金属加工+48%
- セラミックス+45%, 石英+36%, シリコンパーツ+105%, CVD-SiC+62%

真空シール・金属加工、ウェーハ加工・再生ウェーハ

- ・真空シール・金属加工:+48%、装置メーカーの金属部品加工需要の取込みが拡大、常山工場の稼働が貢献
- ・再生ウェーハ: 銅陵再生ウェーハ工場が徐々に稼働

半導体材料、洗浄事業

【半導体材料 (石英、シリコンパーツ、セラミックス、CVD-SiC)】

- ・石英: +36%、常山・東台工場の稼働が貢献
- ・シリコンパーツ: +105%、銀川工場の能力増強が貢献
- ・セラミックス:+45%、杭州工場の能力増強が貢献
- ・CVD-SiC :+62%、岡山工場の能力増強・増産が貢献

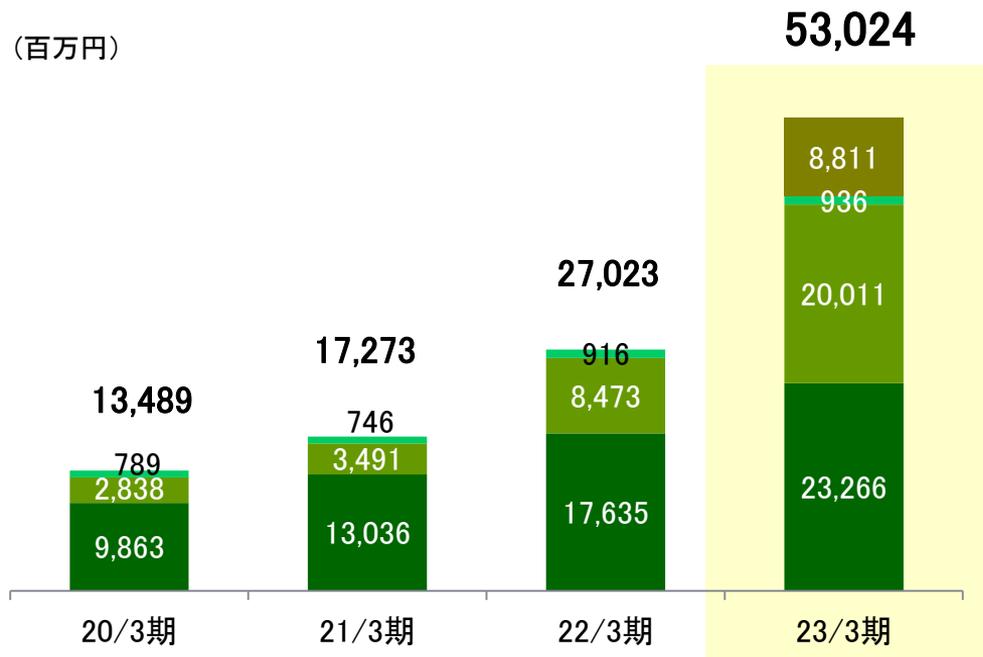
【洗浄事業】

- ・+26%、中国における洗浄需要を取込み

売上高の推移

- サーモジュール
- パワー半導体基板
- 磁性流体、他
- センサ

(百万円)



セグメント総括

- ・パワー基板が+136%の大幅増収で牽引
- ・サーモジュールも売上堅調
- ・センサ増加は、第2四半期からの大泉製作所連結化による

【サーモジュール】

- ・+32%、5G通信向け、バイオ向けが好調

【パワー半導体基板】

- ・+136%、東台を中心とした生産体制の拡充が奏功
- ・特に自動車・EV等向けのAMB基板の増加が顕著
- ・製品開発機能の強化を進め、DPC基板等の製品開発を推進中

連結貸借対照表 ～資産～

(百万円)	2022/3期 期末	2023/3期 期末	増減額
流動資産	133,414	215,341	81,927
現金及び預金	52,579	103,115	50,536
受取手形及び売掛金	41,797	53,276	11,479
たな卸資産	28,436	49,177	20,741
固定資産	131,358	195,306	63,948
有形固定資産	84,083	139,610	55,527
建物及び構築物	22,728	38,080	15,352
機械装置及び運搬具	25,122	44,171	19,049
工具、器具及び備品	5,324	5,984	660
土地	1,895	4,451	2,556
リース資産(純額)	4,040	11,009	6,969
建設仮勘定	24,972	35,913	10,941
無形固定資産	1,996	6,949	4,953
のれん	283	2,304	2,021
投資その他資産	45,277	48,745	3,468
資産合計	264,772	410,648	145,876

【流動資産の主な増加要因等】

- ・現預金+505億円、第三者割当増資を行った中国子会社の現預金増加が主たる要因*
- (*洗浄事業会社+125億円、パワー基板事業会社+177億円、シリコンパーツ・坩堝事業会社+110億円)

【有形固定資産、無形固定資産の主な増加要因等】

- ・各事業における積極的な増産投資等により増加
金属加工、石英、シリコンパーツ、セラミックスの常山工場、石英坩堝銀川工場、セラミックス石川工場、パワー基板四川工場、中国本部建物、再生ウエーハ銅陵工場等
- ・無形固定資産におけるのれん増加は、大泉製作所TOB及び東洋刃物100%子会社化によるもの

【投資その他資産の主な増加要因等】

- ・投資その他の資産+35億円
- ・投資有価証券+45億円、中国のSICデバイス等メーカー、安徽長飛先進半導体の株式取得38億円が主因

連結貸借対照表 ～負債及び純資産～

(百万円)	2022/3期 期末	2023/3期 期末	増減額
流 動 負 債	68,800	111,294	42,494
支払手形及び買掛金	26,702	40,524	13,822
短期借入金	6,324	20,378	14,054
1年内返済長期借入金 +1年内償還社債	8,501	15,825	7,324
固 定 負 債	35,014	49,697	14,683
社債	8,806	4,083	△ 4,723
転換社債型新株予約権付社債	2,134	-	△2,134
長期借入金	11,796	26,432	14,636
負 債 合 計	103,814	160,991	57,177
純 資 産	160,957	249,656	88,699
株主資本	117,511	166,955	49,444
その他の包括利益累計額	13,511	16,773	3,262
非支配株主持分	29,888	65,887	35,999
負 債 ・ 純 資 産 合 計	264,772	410,648	145,876
自 己 資 本 比 率	49.5%	44.7%	-4.8%

【流動負債、固定負債の主な変動要因等】()内は2022/3期末比

短期借入+1年内長借・社債 589億円 (+217億円)
 長期借入+社債・転換社債 227億円 (+78億円)
 有利子負債 合計 667億円 (+292億円)

【純資産の主な変動要因等】()内は2022/3末比

・資本剰余金 +219億円、利益剰余金 +263億円
 非支配株主持分 +360億円
 中国子会社の第三者割当増資により、資本剰余金・非支配株主持分が各増加(パワー基板事業:108億円・148億円、シリコンパーツ・坩堝事業:52億円・66億円、洗浄事業:44億円・92億円)

【自己資本比率】

・自己資本比率は44.7%

注 為替レート2022/3月期1→2023/3月期 : 米ドル 115.02円→132.70円 人民元 18.06円→19.01円(期末レート)

キャッシュフロー計算書

(百万円)	2022/3期	2023/3期
営業活動によるキャッシュフロー	17,833	43,024
税金等調整前四半期純利益	33,648	42,041
減価償却費	8,085	12,618
為替差損益(△:益)	△ 2,026	△ 1,402
売上債権の増減(△:増加)	△ 4,258	△ 3,139
たな卸資産の増減(△:増加)	△ 9,126	△ 14,354
仕入債務の増減(△:減少)	6,065	6,516
持分変動損益(△:益)	△ 9,327	△ 651
その他	△ 5,228	1,395
投資活動によるキャッシュフロー	△ 29,399	△ 68,760
有形固定資産取得による支出	△ 33,585	△ 56,001
有形固定資産の売却による収入	400	236
無形固定資産の取得による支出	△ 241	△ 976
関係会社株式の取得による支出	△ 1,278	△ 849
その他	5,305	△ 11,170
財務活動によるキャッシュフロー	30,601	68,718
短期借入金の増減額	180	11,687
長期借入れによる収入	2,545	24,256
長期借入金の返済による支出	△ 6,944	△ 8,311
株式の発行に関する収入	19,275	11
非支配株主からの払込みによる収入	22,701	47,607
その他	△ 7,156	△ 6,532
現金及び現金同等物の増加額	22,376	43,326
現金及び現金同等物の期首残高	30,202	52,579
現金及び現金同等物の期末残高	52,579	95,905

【営業CFの状況】

税金等調整前純利益+減価償却費: 546億円

売上債権・棚卸資産・仕入債務の増減: △110億円

【投資CFの状況】

有形固定資産の取得: △560億円

金属加工、石英、シリコンパーツ、セラミックス、石英坩堝、
パワー基板、中国本部建物、再生ウエーハにおける支出

その他: △112億円

定期預金純増減 △70億円
投資有価証券の取得 △46億円

【財務CFの状況】

非支配株主からの払込みによる収入: 476億円

FTNC(シリコンパーツ・石英坩堝) 105億円

FLH(パワー半導体基板) 239億円

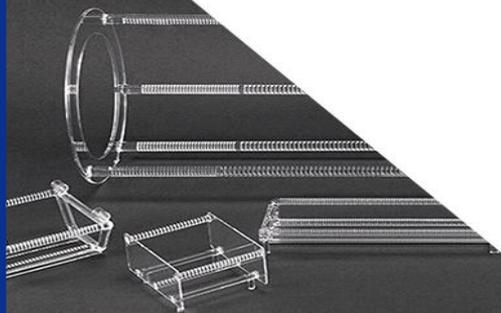
FTSVA(洗浄) 129億円



FerroTec
Ferrotec Holdings Corporation



2024年3月期 通期業績予想

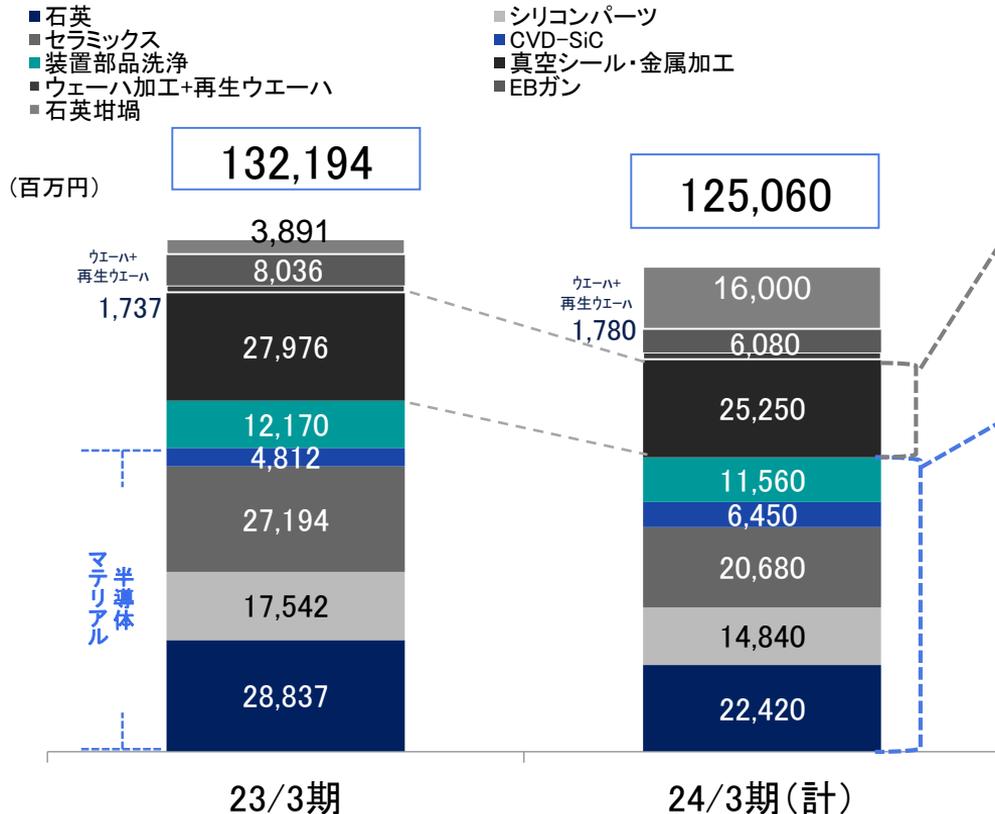


- 2024/3期売上高2,200億円(+4.4%)、営業利益325億円(△7.3%)、当期純利益180億円(△39.4%)
- 売上高は、半導体マテリアル製品等の減収をカバーし増収も、減益を予想

(百万円)	2023/3期	2024/3期(計)	前期比(%)	計画の詳細・前提
売上高	210,810	220,000	4.4	・市況悪化によりマテリアル製品等の減収を見込む 石英坩堝・パワー半導体基板の伸長にて売上維持
営業利益	35,042	32,500	△7.3	・営業利益面では、マテリアル製品等の減益及び減 価償却費増加等をカバーできず、営業減益予想
経常利益	42,448	30,000	△29.3	・前期営業外利益の為替差益55億円剥落
親会社に帰属する 当期純利益	29,702	18,000	△39.4	・特別損益の発生は予想せず
減価償却費	12,618	17,400	37.9	・中国工場増設等により減価償却費が増加
EBITDA	47,660	49,900	4.7	-
投資額*	62,661	96,900	54.6	マレーシア(セラミックス、石英、金属加工等)、常山 (シリコンパーツ等)、四川(パワー基板)投資等
想定為替レート(期中平均)	米ドル: 132.08円 人民元: 19.50円	米ドル: 130.00円 人民元: 19.00円	-	-

注 投資額=有形資産、無形固定資産、有価証券の取得等の合計

売上高の推移



セグメント総括

- ・市況悪化、顧客の在庫調整等の影響から、真空シール・金属加工、半導体材料は減収を予想
- ・石英坩堝が大幅に売上拡大

真空シール・金属加工

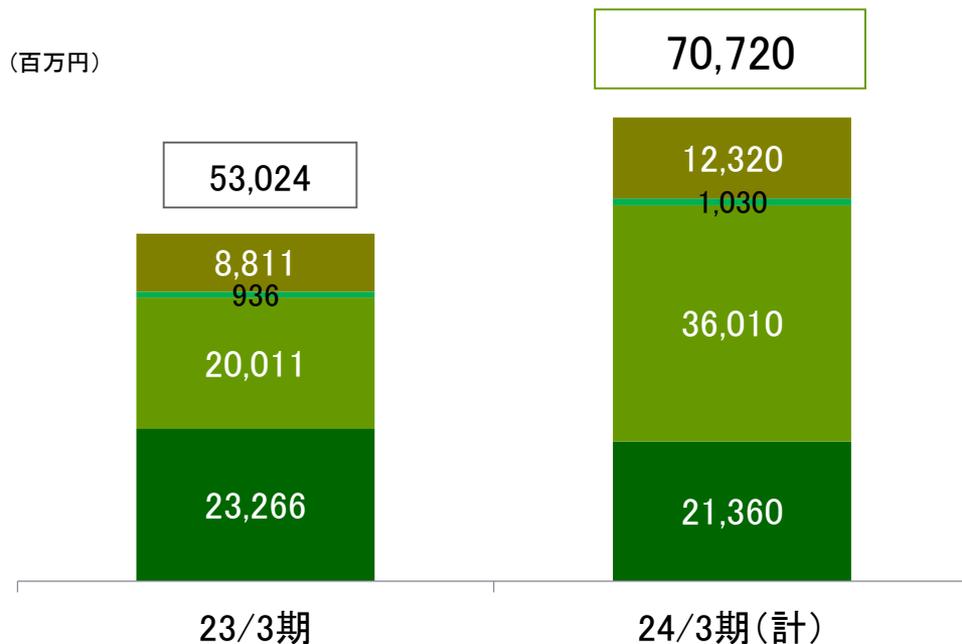
- ・半導体市況の悪化を受け、半導体製造装置向け金属加工の需要が減少、△10%の減収予想

半導体材料、洗浄事業

- 【半導体材料（石英、シリコンパーツ、セラミックス、CVD-SiC）】
- ・ 石英: △22%、市況悪化を受けた顧客の在庫調整等の影響
 - ・ シリコンパーツ: △15%、顧客の在庫調整等の影響
 - ・ セラミックス: △24%、半導体設備投資減少、顧客在庫調整の影響
 - ・ CVD-SiC : +34%、需要底堅く、岡山工場増産により売上拡大
- 【石英坩堝・洗浄事業】
- ・ 石英坩堝: +311%、大口径坩堝の生産体制拡充、PV向け需要拡大
 - ・ 洗浄: △5%、需要減少の影響から減収

売上高の推移

■ サーモモジュール ■ パワー半導体基板 ■ 磁性流体・その他 ■ センサ



セグメント総括

- ・サーモモジュール減速、パワー基板は成長継続
 - ・センサ増加は、大泉製作所の前期第二四半期連結化による
- 【サーモモジュール】
- ・△8%、通信向け、医療向けとも需要が低減
- 【パワー半導体基板】
- ・+80%、DCB基板の売上堅調、自動車・EV向けAMB基板の成長が継続

24/3期 セグメント・製品別の業績予想



(百万円)	23/3期	24/3期	増減率(YoY)
半 導 体 等 装 置 関 連	132,194	125,060	△ 5.4
真空シール・金属加工	27,976	25,250	△ 9.7
石英製品	28,837	22,420	△ 22.3
シリコンパーツ	17,542	14,840	△ 15.4
セラミックス	27,194	20,680	△ 24.0
CVD-SiC	4,812	6,450	34.0
EBガン・LED蒸着装置	8,036	6,080	△ 24.3
ウエーハ加工(連結対象外)	236	160	△ 32.2
再生ウエーハ	1,501	1,620	7.9
装置部品洗浄	12,170	11,560	△ 5.0
石英坩堝	3,891	16,000	311.2
電 子 デ バ イ ス	53,024	70,720	33.4
サーモモジュール	23,266	21,360	△ 8.2
パワー半導体	20,011	36,010	80.0
磁性流体・その他	936	1,030	10.0
センサ	8,811	12,320	39.8
そ の 他	25,590	24,220	△ 5.4
合 計	210,810	220,000	4.4

24/3期計画値 上期と下期 業績別

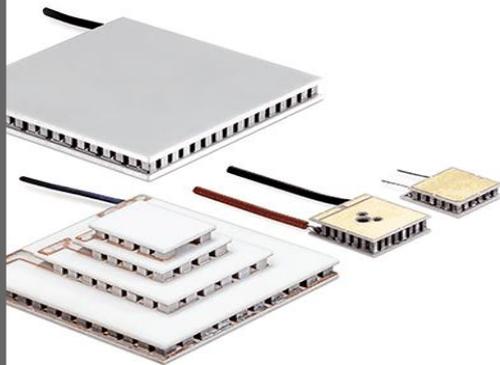
(百万円)	2024年3月期上期 計画		2024年3月期下期 計画			
	金額	売上比(%)	金額	売上比(%)	増減額	増減率(%)
売上高	105,000	100.0	115,000	100.0	10,000	9.5
売上総利益	33,500	31.9	37,000	32.2	3,500	10.4
販売管理費	18,500	17.6	19,500	17.0	1,000	5.4
営業利益	15,000	14.3	17,500	15.2	2,500	16.7
経常利益	13,500	12.9	16,500	14.3	3,000	22.2
当期純利益	8,500	8.1	9,500	8.3	1,000	11.8

23/4期計画値 上期と下期 製品別

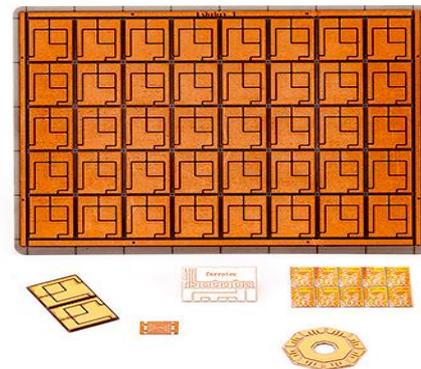
(百万円)	2024年3月期上期 計画		2024年3月期下期 計画			
	金額	売上比(%)	金額	売上比(%)	増減額	増減率(%)
半 導 体 等 装 置 関 連	58,900	56.1	66,160	57.5	7,260	12.3
真空シール	12,430	11.8	12,820	11.1	390	3.1
石英製品	11,150	10.6	11,270	9.8	120	1.1
シリコンパーツ	7,460	7.1	7,380	6.4	△ 80	△ 1.1
セラミックス	10,900	10.4	9,780	8.5	△ 1,120	△ 10.3
CVD-SiC	2,980	2.8	3,470	3.0	490	16.4
EBガン・LED蒸着装置	3,020	2.9	3,060	2.7	40	1.3
ウエーハ加工(連結対象外)	40	0.0	120	0.1	80	200.0
再生ウエーハ	760	0.7	860	0.7	100	13.2
部品洗浄	5,560	5.3	6,000	5.2	440	7.9
石英坩堝	4,600	4.4	11,400	9.9	6,800	147.8
電 子 デ バ イ ス	34,590	32.9	36,130	31.4	1,540	4.5
サーモジュール	11,670	11.1	9,690	8.4	△ 1,980	△ 17.0
パワー半導体基板	16,940	16.1	19,070	16.6	2,130	12.6
磁性流体・その他	480	0.5	550	0.5	70	14.6
センサ	5,500	5.2	6,820	5.9	1,320	24.0
そ の 他	11,510	11.0	12,710	11.1	1,200	10.4
合 計	105,000	100.0	115,000	100.0	10,000	9.5

注 ウエーハ加工については今期より連結対象外となるため記載を割愛

※数値については一部丸め処理を行ったものを記載



FerroTec
Ferrotec Holdings Corporation

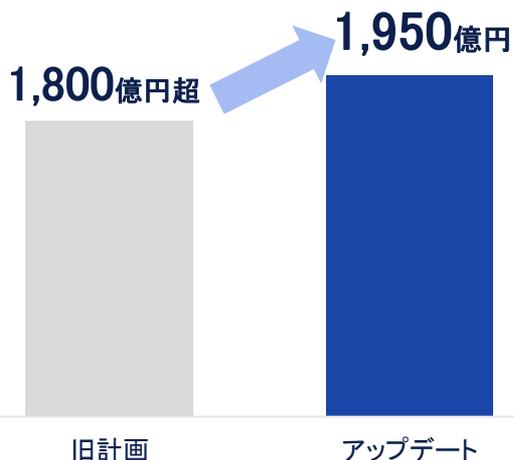


財務運営・設備投資について



- グローバル生産体制の強化等に向けて投資金額を増額、3年間投資合計1,950億円へ修正
- 持続的な成長へ向けて、自動車セグメントにおける投資、戦略投資の検討を継続

22/3期～24/3期 投資計画



【現在までの投資実績】 *有形資産、無形固定資産、有価証券の取得等の合計

1. 22/3期は354億円、23/3期627億円の計981億円の実績
2. 半導体マテリアル製品、パワー半導体基板の需要増に対応、増産投資実施
3. マレーシア工場、石川新工場設立、熊本工場の設立に着手
4. 東洋刃物の100%子会社化、大泉製作所の51%出資・連結化を実施

【成長投資の方向性】

1. グローバル生産体制の強化を加速(マレーシア、日本の製造拠点強化)
2. パワー半導体等、自動車セグメントにおける積極投資を継続
3. 事業関連性や潜在的成長力等に照らしたM&Aの検討を継続

資金調達の実績等について

- 23年3月までに、中国子会社・当社の増資の累計888億円の資本調達を実施
- 引き続き、投資機会と財務状況の適切なバランスを確保する



- 当社単体の増資: 193億円(2021年12月)
中国子会社の増資(22/3期～23/3期):
 - ・パワー半導体基板 322億円
 - ・SIパーツ 196億円
 - ・洗浄 129億円
 - ・再生ウエーハ 48億円

計	695億円
---	-------
- 3カ年の営業CF合計額は、990億円を予想
- 引き続き、投資機会と財務状況の適切なバランスを確保、当期純利益の重視、投資リターン・ROIC管理の強化を継続

当社が想定する子会社の上場スケジュール

- 部品洗浄子会社は、2022年12月30日に深セン創業板市場に上場。(公募価格8.48元)
- パワー半導体基板子会社は上場可能時期が不透明のため証券会社とのアドバイザー契約を一旦解除、調整中

事業	部品洗浄	石英坩堝・シリコンパーツ	パワー半導体用基板	シリコンウエーハ（持分法）	
会社名	安徽富楽徳科技發展股份有限公司	寧夏盾源聚芯半導體科技股份有限公司	江蘇富樂華半導體科技股份有限公司	杭州中欣晶圓半導體股份有限公司	
略称	FTSVA	FTNC	FLH(旧FTSJ)	CCMC	
現在の出資比率	50.23%*	60.13%	55.10%	23.05%	
上場市場	深セン・創業板	深セン・主板	上海・科創板	上海・科創板	
上場アドバイザー	光大証券	東方証券承销保荐	華泰綜合証券	海通証券	
直近評価額	544億円（上場公募価格）	1,053億円	1,463億円	2,813億円	
新株発行予定比率	25%	25%	25%	25%	
進捗・目標スケジュール	上場アドバイザー登録	2020/8/11	2021/11/4	—	2021/10/20
	上場申請提出	2021/6/28	2023年上期(目)	未定	2022/8/30
	上場審査合格	2022/5/6	—	—	—
	上場正式承認	2022/11/16	—	—	—
	上場予定日	2022/12/30	2024年後半(目)	未定	2023年後半(目)

*FTSVA出資比率は上場後の数値を記載。

**評価額は2021年以降の第三者割当増資時に算定した株価で計算、人民币19.01

FTSVA IPO完了(22年12月)



深セン創業板上場セレモニーの様子



(ご参考) FTSVA(富乐德) 株価チャート(百度)

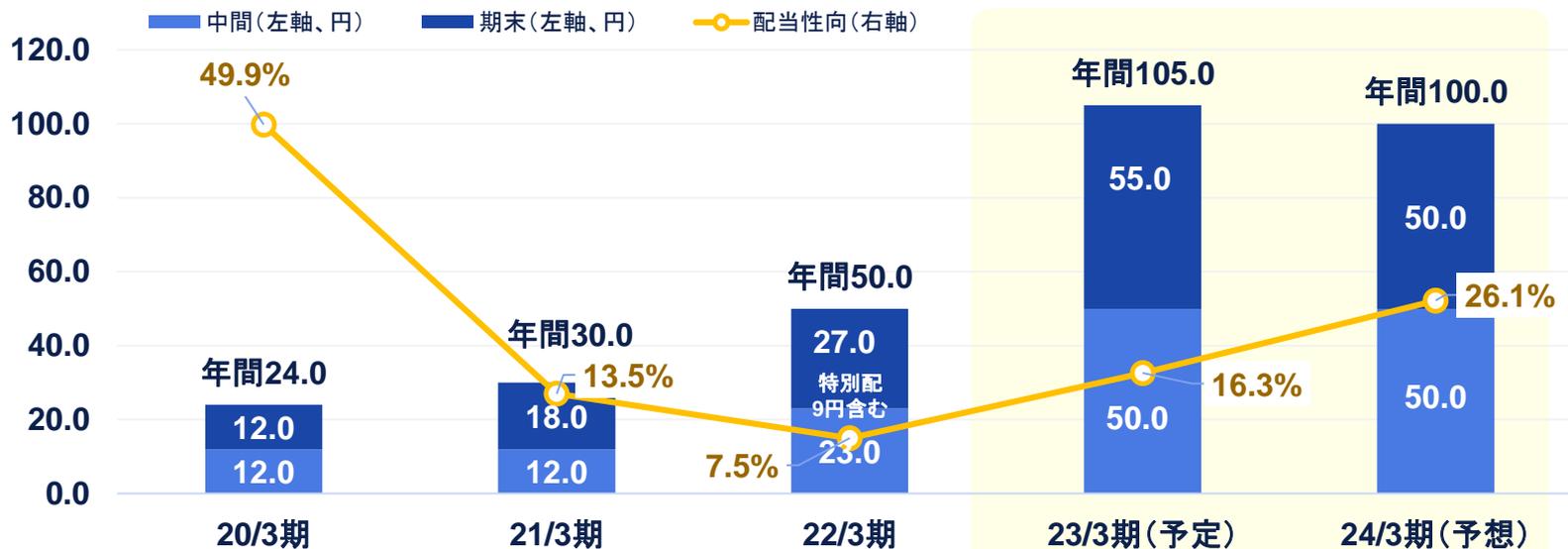
・IPOによる調達総額は717,408千元(約141億円)。上場後直近株価も公募価額8.48元を大きく上回る状況。

持続的な収益増強により株主還元を増加させていくことが基本方針、配当の決定に際して、「配当性向20%」を意識して、財務・投資機会等とのバランスを考慮して判断する(2022年5月30日開示内容)、との配当政策は不変

23/3期は、決算内容・業績・投資状況等を考慮し、1株当たり配当額は年間105円の予定

24/3期は、25/3期以降の業績改善見通し及び23/3期配当水準等を考慮し、年間100円の予想

1株当たり配当金の推移





株式会社フェローテックホールディングス 中期経営計画のアップデート

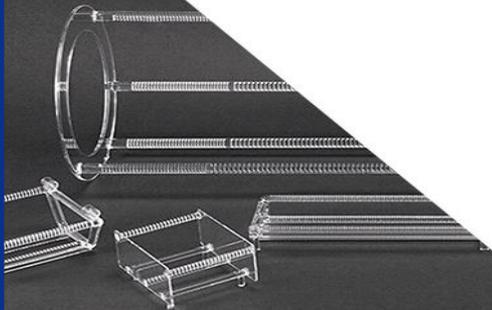
2023.6.1(木)



FerroTec
Ferrotec Holdings Corporation



23/3期までの現状認識



23/3期:売上高、営業利益は過去最高を達成

- 半導体マテリアル製品、部品洗浄、パワー半導体基板などの好調により、売上高、営業利益は過去最高を記録
- 中期経営計画において掲げた目標値を超過

売上高

(百万円)



営業利益

(百万円)

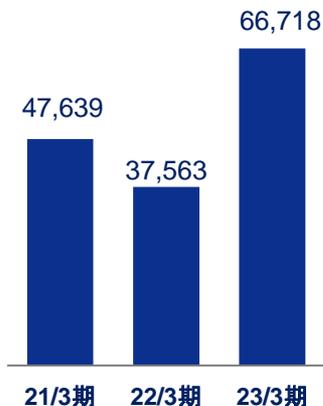


- 自己資本比率、ROE、ROICの各指標とも、中計で掲げた水準を超過

主要指標の推移

有利子負債

(百万円)



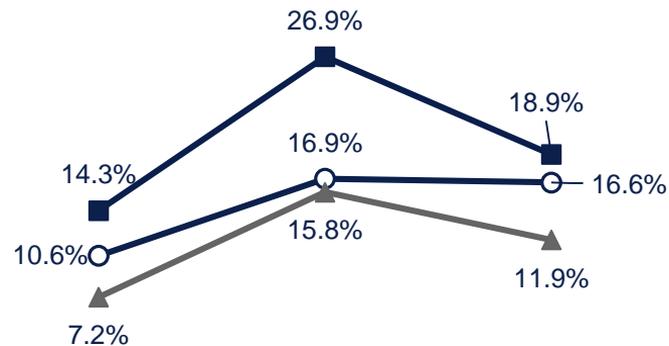
自己資本比率



21/3期 22/3期 23/3期

収益性指標(営業利益率、ROE、ROIC)

○ 営業利益率 ■ ROE ▲ ROIC



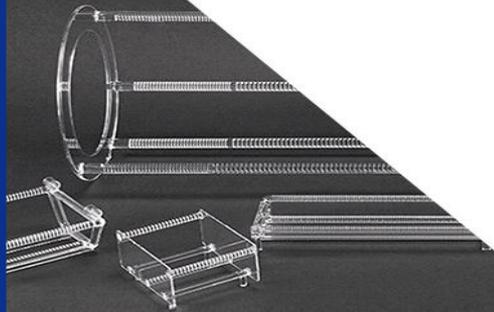
21/3期 22/3期 23/3期



Ferrotec
Ferrotec Holdings Corporation



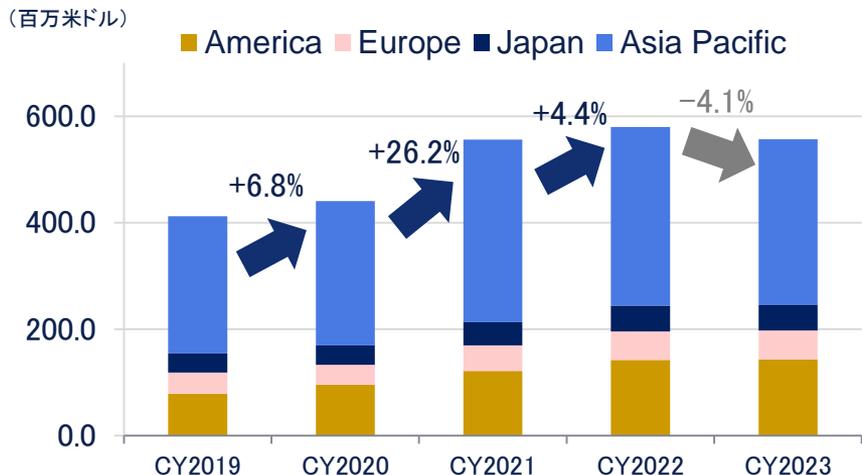
市場環境・当社の現況の認識



半導体市場の認識

- 半導体需要は中長期的には好調も、在庫調整等によりCY2023は調整局面の見通し
- WFE(半導体製造装置前工程)市場の前年比成長率は、CY2025から再びプラス成長の見通し

世界地域別市場予測

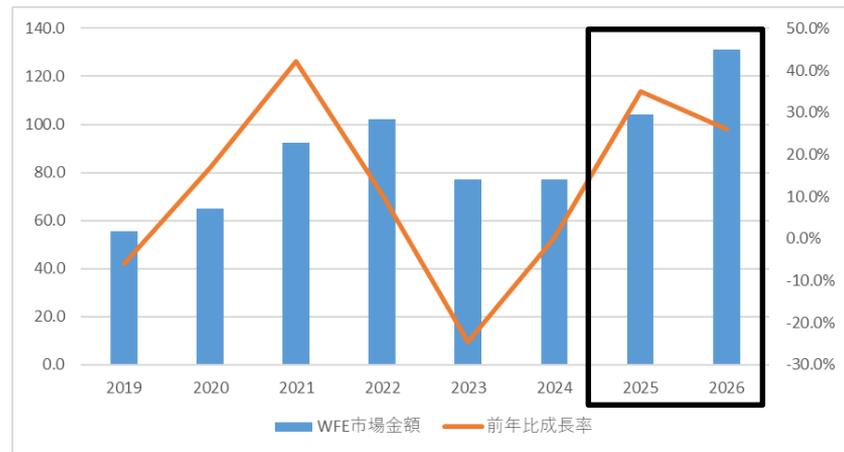


	CY2019	CY2020	CY2021	CY2022	CY2023
Total IC	412.3	440.4	555.9	580.1	556.6

*出典: WSTS日本協議会公表データ(22年11月)を基に当社作成

WFE(半導体製造装置前工程)市場予測

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
WFE市場金額	55.5	64.9	92.3	102.0	77.0	77.0	104.0	131.0
前年比成長率	-6.0%	16.9%	42.2%	10.5%	-24.5%	0.0%	35.1%	26.0%



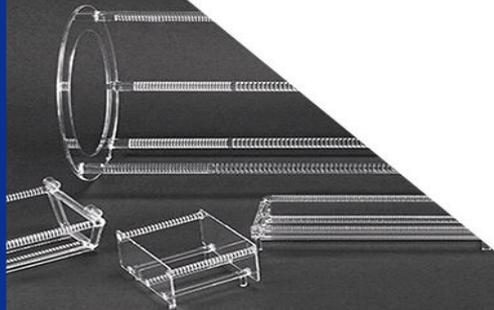
*某証券会社の資料を基に当社作成



FerroTec
Ferrotec Holdings Corporation



中期経営計画のアップデート



事業成長

- 成長の徹底追及、積極投資を継続
- 既存事業の競争力強化・シェアアップに加え、非半導体事業の強化を推進
- 「車載セクター」を新設・戦略的に強化(24/3期1Qから計数開示、25/3期から開示セクターに)
- 製品開発やM&A等により、事業・製品の多様化を加速

グローバル 生産体制の強化

- マレーシア拠点の早期稼働
- 石川工場、熊本工場の立ち上げ、「日本回帰」を推進

経営基盤 の強化

- 品質管理の強化を継続
- デジタル化・自動化・AI化・見える化を継続推進
- 人材強化の継続

財務・ 株主還元

- 投資機会と財務の適切なバランス確保、当期利益重視・ROIC管理強化を継続
- 収益増強により株主還元を増加させていく基本方針、配当性向20%を意識

	中期経営計画(2022/3期~2024/3期)			目標値	
	22/3期(実)	23/3期(実)	24/3期(予)	25/3期(計)	26/3期(計)
(金額の単位は百万円)					
売上高	133,821	210,810	220,000	270,000	360,000
営業利益	22,600	35,042	32,500	45,000	60,000
営業利益率	16.9%	16.6%	14.8%	16.7%	17.5%
当期純利益	26,659	29,702	18,000	25,000	36,000
ROE	26.9%	18.9%	15%目標		
ROIC*	15.8%	11.9%	8%目標		
自己資本比率	49.5%	44.7%	40%目標		
投資額**	35,378	62,661	96,900	60,000程度	未定
1株当たり配当金 (年間)	50.0円	105.0円	100.0円		

※ *ROIC =親会社帰属純利益/(有利子負債+純資産) 純資産は新株予約権、非支配株主持分除く

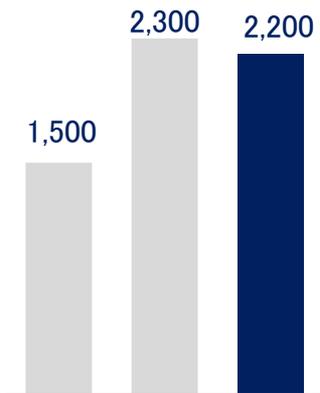
**投資額は、有形資産、無形固定資産、有価証券の取得等の合計 M&A投資機会により変動する

- 中計最終年度(24/3期)の目標値を売上高で旧計画比+53%、当期純利益*で同+40%と大幅に引上げ
- 25/3期計画は売上高2,700億円、営業利益450億円、当期純利益250億円と更なる伸長を計画

24/3期における中計数値の推移

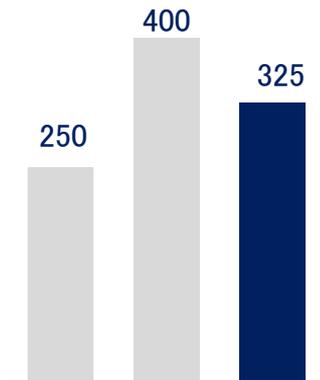
(金額は億円、数値は全て24/3期の計画値を指す)

売上高



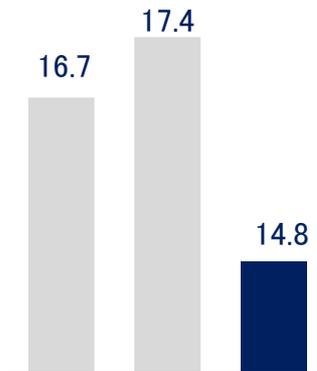
初回策定 22.5.30 修正 今回修正

営業利益



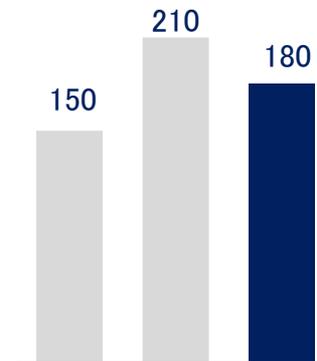
初回策定 22.5.30 修正 今回修正

営業利益率



初回策定 22.5.30 修正 今回修正

当期純利益



初回策定 22.5.30 修正 今回修正

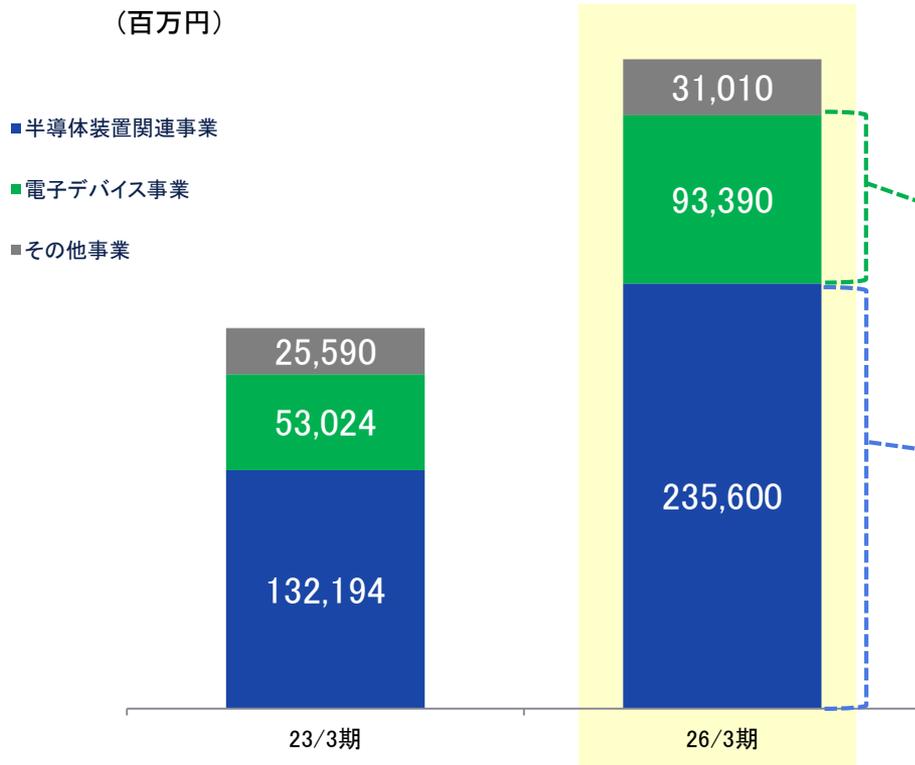
主な工場新設・生産能力増強の状況

2024年以降の成長へ向けて、工場の新・増設を着々と進め、生産能力を拡大中。以下は現時点の主な予定



所在地	対象事業	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	生産能力想定 (億円)
中国 東台・内江	パワー半導体用基板								560
日本 石川県	セラミックス								140
中国 常山	セラミックス シリコンパーツ								150
中国 銀川	石英坩堝								340
マレー シア	金属加工・石英 セラミックス								250
日本 熊本県	マテリアル・洗浄								未定

売上高の推移



全体

- ・売上2,108億円⇒3,600億円、3年間で+71%の増収目標
- ・グローバル生産体制の拡充を着実に進めており、半導体セクターの需要回復時には、目標売上の達成は可能
- ・デジタル化・自動化・AI化による生産性向上も継続的に実行
- ・M&A等による事業拡大時により、更なる成長も追及

電子デバイスセグメント

- ・売上530億円⇒934億円、3年間で+76%の増収目標
- ・パワー半導体基板の四川工場設立による増産体制を着実に進めており、2024年には生産本格化見通しであり、実現は可能

半導体等装置関連セグメント

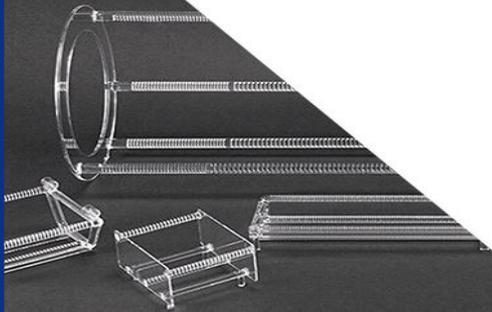
- ・売上1,322億円⇒2,356億円、3年間で+78%の増収目標
- ・グローバル生産体制の拡充、自動化等を着実に進めており、需要回復時には急速な売上拡大の実現が可能
- ・常山(石英、金属加工、シリコンパーツ等)
 - ・マレーシア(金属加工、石英、セラミックス)
 - ・石川(セラミックス)
 - ・岡山(CVD-SiC)



FerroTec
Ferrotec Holdings Corporation

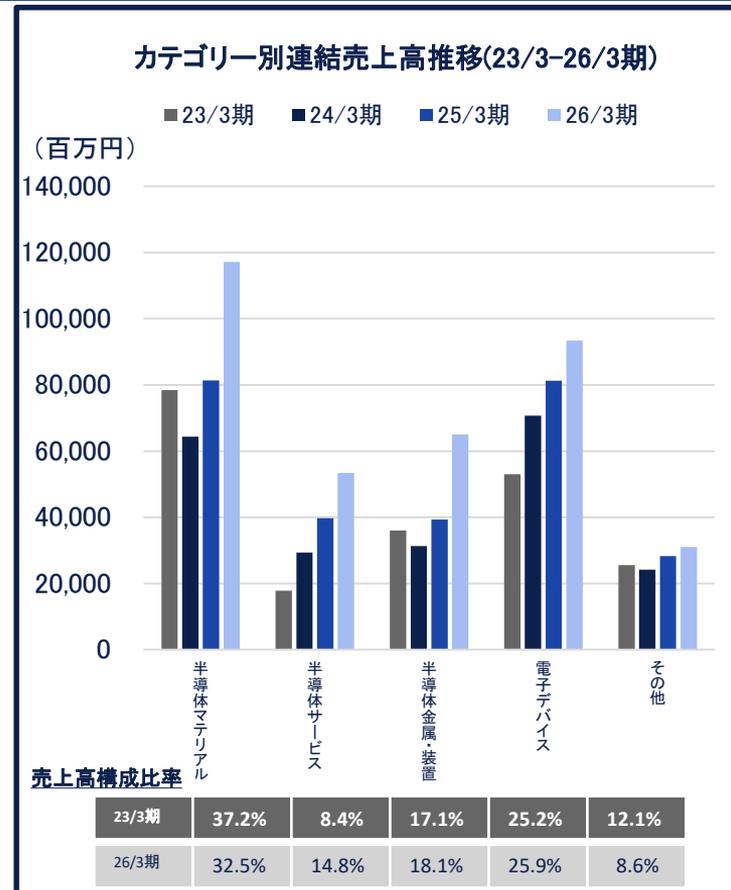


注力製品の事業戦略



カテゴリー別目標売上高(26/3期の姿)

	カテゴリー	製品構成	23/3期実績	26/3期(目標)	増減率 (23/3期対26/3期)
A	半導体 マテリアル	石英 セラミックス シリコンパーツ、 CVD-SiC等	78,385	117,100	+49.4%
B	半導体 サービス	部品洗浄、るつぼ、 再生ウエーハ等	17,798	53,430	+200.2%
C	半導体金属・ 装置	真空シール 金属加工、 蒸着装置等	36,012	65,070	+80.7%
D	電子 デバイス	サーモジュール パワー半導体基板、 センサ、磁性流体	53,024	93,390	+76.1%
E	その他	刃物、クリーニング、 その他製造装置等	25,591	31,010	+21.2%
A+B+C+ D+E	総合計 (連結売上高)		210,810	360,000	+70.8%
A+B+C	半導体等装 置関連のみ 計	マテリアル/サービ ス/金属・装置計	132,194	235,600	+78.2%

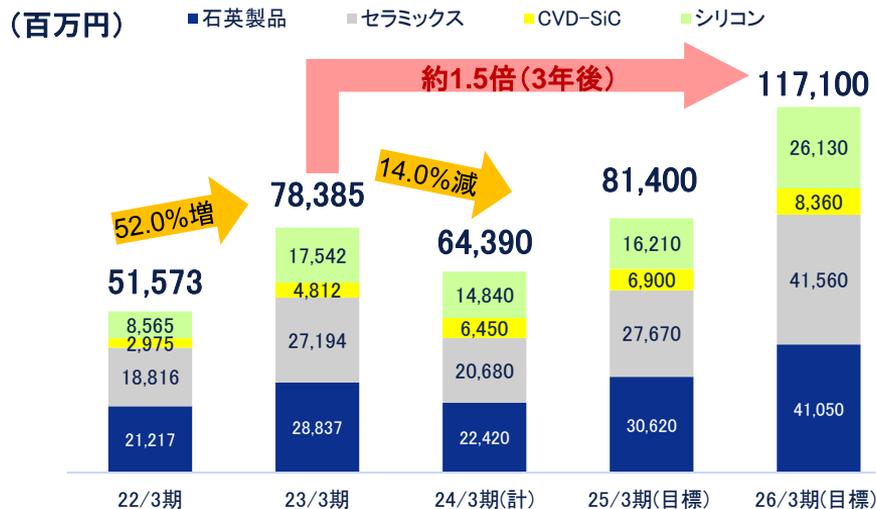


*対象製品は石英、セラミックス、CVD-SiC、シリコンの4製品



23/3期 前年比52.0%

売上高推移 (22/3期~26/3期)



- 24/3期は前年比14.0%減収の見通し
- 半導体市場は、デジタル投資、EV需要拡大等、23/3期は堅調に推移
- WFE(Wafer Fab Equipment)半導体前工程製造装置市場は、23年(24/3期)は調整局面。中長期での市場成長の見方は不変
- 25年(26/3期)以降の市況拡大を見越し、各製品の生産能力拡大を継続

石英: マレーシア・熊本に新工場建設

セラミックス: マレーシア・石川に新工場建設

※CVD-SiCは岡山、常山(新工場)、シリコンは常山で拡大予定

石英坩堝の状況と今後の見通し



※銀川で半導体/太陽電池向け石英坩堝の事業を展開

売上高推移(22/3期~26/3期)

(百万円)

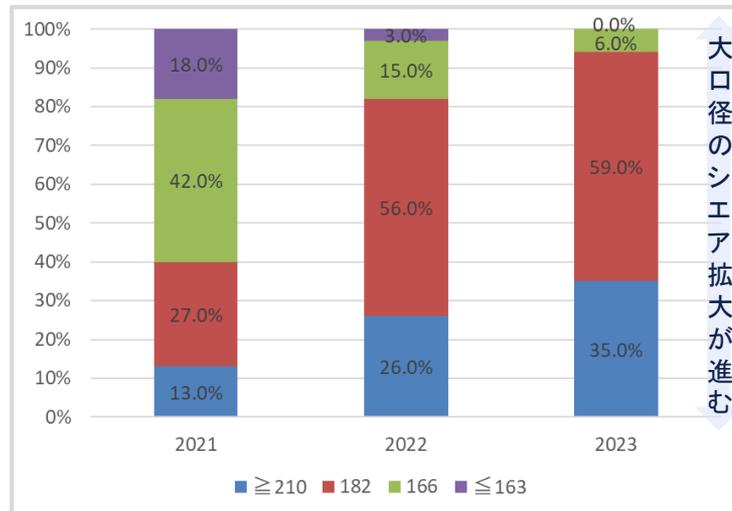


23/3期売上高は前年比85.3%増、24/3期は311.2%大幅増見通し

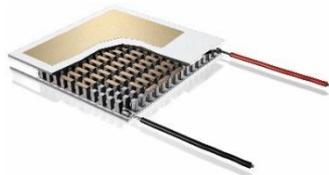
- 太陽電池市場の導入量拡大、およびウェーハサイズの大口径化に対応した石英坩堝の大口径化のトレンドが顕著となり、銀川工場での生産能力増強投資を対応中
- 23/3期比較で、3年後には。約**8.9倍**の売上規模を目標とする

太陽電池ウェーハサイズ別市場シェア見通し(単位:mm)

※2022-2023年は予測。PV Infolinkの情報を基に当社作成



サーモジュール製品の状況と今後の見通し



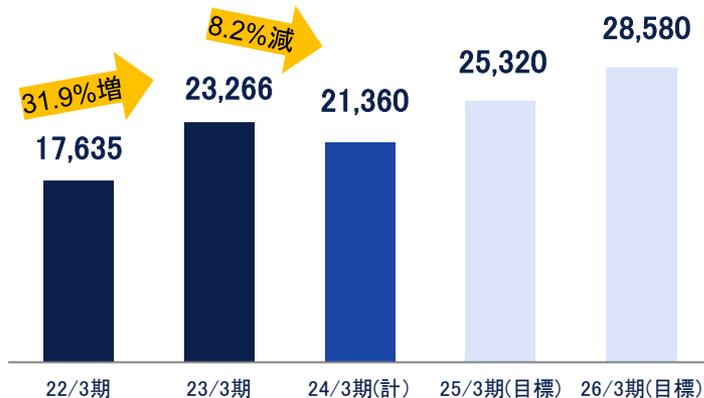
サーモジュール



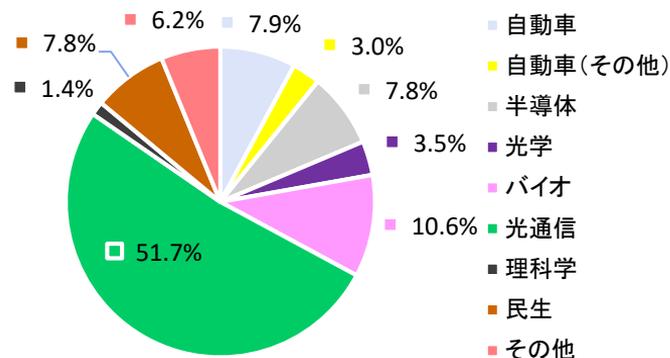
新製品: 冷却チラー

(百万円)

売上高推移(22/3期～26/3期)

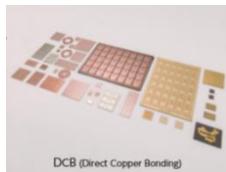


23/3期 サーモジュールの用途別構成比率



23/3期は前年比: 31.9%増収

- 24/3期は8.2%の減収見通し(5G通信機器用途、PCRなどバイオ装置用途、半導体分野において、ややピークアウト(25/3期からは再び増収の見通し))
- 新製品の冷却チラーは、サーモジュール(ペルチェ)方式、コンプレッサー方式を複数モデルラインアップし、半導体分野の他、工作機械、医療装置分野等での拡販に取り組む



※東台「パワー半導体研究院」(次世代製品開発強化)

(百万円)

売上高推移(22/3期～26/3期)

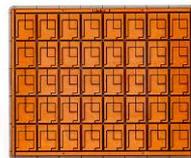


23/3期は前年比 136.2%増収

- 24/3期は前年比180.0%増収見通しと成長は持続
- 四川省内江に新工場を建設(23年6月竣工予定)
- 東台のパワー半導体基板工場は生産能力拡大中、来期以降も増収の見通し(月産能力:上海・東台工場 DCB基板 110万枚→160万枚、AMB基板 20→45万枚へ増産計画中)
- 高耐熱・高強度のDPC基板も、光通信やパワーLED製品等への展開強化

★世界的な消費電力抑制気運から、DCB基板は更に需要拡大

※車載用途で、AMB基板売上も一定水準の売上規模に



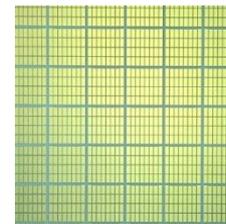
DCB基板
(Direct Copper Bonding)

材質: アルミナセラミックス



AMB基板
(Active Metal Brazing)

材質: 窒化ケイ素



DPC基板
(Direct Plated Copper)

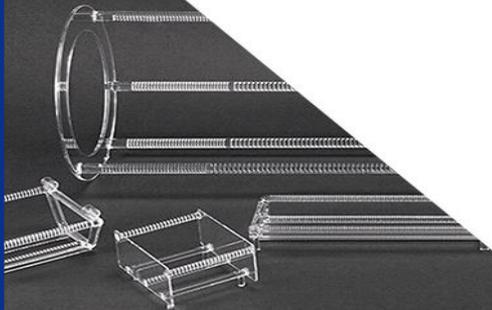
材質: アルミナセラミックス等
メタライズ(Ni等)



FerroTec
Ferrotec Holdings Corporation



直近のトピックス
新規事業への取組み等



- EV(電気自動車)等の需要増から、パワー半導体基板、温度センサの成長により、26/3期350億円程度への売上増を想定
- EV市場拡大、自動運転の進展等を追い風に、更なる戦略的な拡大を検討していく

車載用に事業拡大できる当社製品群



パワー半導体
基板

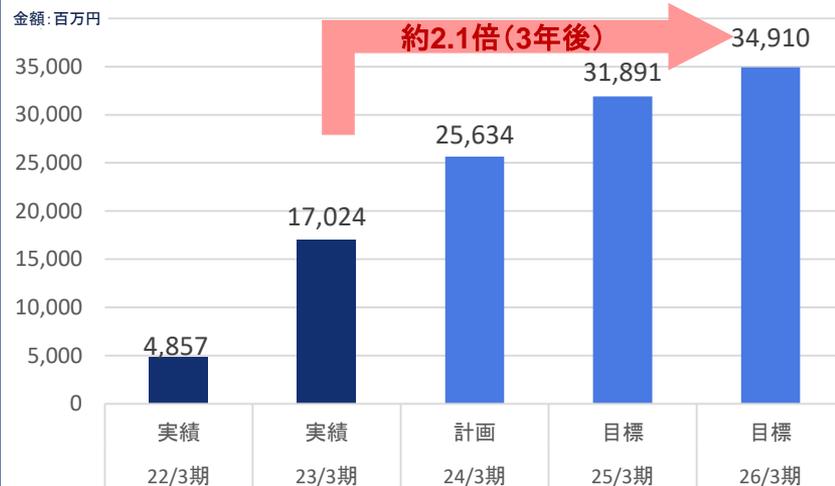


サーモ
モジュール



センサ

車載向け連結売上高推移(～26/3期・現時点の想定)



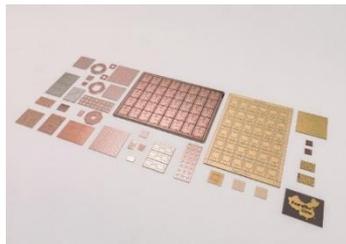
単位:千台 世界自動車販売台数、および次世代車(XEV)販売台数予測



※上記数値は電子デバイス事業の内、車載向けの売上高に該当するものを対象としています。

※データは矢野経済研究所調べ

■ 電子デバイス事業では、従来から多業界で採用が拡大する温調デバイス「サーモモジュール」に加えて、世界的な省エネ化トレンドに沿った「パワー半導体絶縁基板」が大きな事業の柱に成長



- DCB基板
- アルミナセラミックス
- 産業機器、家電分野



- AMB基板
- 窒化ケイ素・アルミニウム
- EV(電気自動車)、鉄道車両
- ※ EV市場の伸長で需要急拡大

■ 連結子会社に加わった 下記2社も中期的に事業拡大を目指す
 ・「(株)大泉製作所」温度センサは車載向け・空調向け、サーミスタ(素子)は光通信分野などに注力
 ・「東洋刃物(株)」工業用刃物は情報産業分野などを中心に、国内・中国の市場開拓を強化

サーミスタ 電子デバイス

温度変化に敏感な半導体セラミックス

サーミスタは温度変化に対し、極めて大きな抵抗変化を示す半導体セラミックスです。その性質を利用して、車載・家電・光通信などの温度センサとして幅広く使用され、車両電動化やデジタル化でその需要は拡大しています。大泉製作所はサーミスタ専門のニッチトップとして高品質なサーミスタをグローバルのTier1企業に供給しています。

※サーミスタ(Thermistor)は、Thermally Sensitive Resistorの通称です。

センサで世界を測る。未来を拓く。
OHIZUMI



何れも今後生産能力拡大、
 自動化を推進(フェローテックとのシナジーを最大化)

工業用刃物

Industrial knife

東洋刃物株式会社では、スマートフォンの電子部材、自動車、段ボール等様々なものづくりの現場で使われる機械刃物を生産しています。大正14年から培われた技術・品質を強みとして、情報産業、鉄鋼、紙・木材関連、食材などあらゆる素材に対応する機械刃物を提供し、お客様のご要望にお応えしております。

東洋刃物株式会社
 TOYO KNIFE CO., LTD.

その他

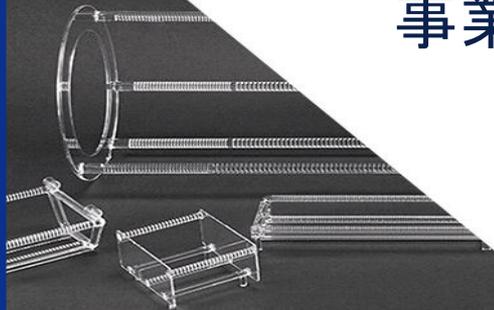




Ferrotec
Ferrotec Holdings Corporation



グローバル戦略、 事業ポートフォリオの強化について



- マレーシアケダ州クリム・ハイテクパーク内（ペナン島近隣）に製造子会社 Ferrotec Manufacturing Malaysia を設立（22年4月）。23年11月頃竣工予定
※東南アジア顧客に密着した事業展開（石英・セラミックス・金属加工/組立等）



マレーシア・シンガポール当社拠点



23年5月棟上げ式の様子



完成予想図



石英



セラミックス



金属加工/組立

生産拠点：グローバル戦略「日本：石川増強、熊本新拠点」

- 中長期での需要拡大が見込まれる半導体製造装置関連部材「ファインセラミックス」「マシナブルセラミックス」の増産を石川エリアで対応中
 ※22年11月 第2工場竣工、第3工場も用地を確保し、24年半ばに竣工予定



23年3月熊本
 県大津町用地
 での地鎮祭の
 様子



当社の日本国内拠点マップ

★石川では、セラミックスの更なる増産へ向け、第3工場の用地も取得済み



石川第2工場 セラミックス拠点

★「シリコンアイランド」九州の熊本県大津町に生産拠点を新設予定(24年6月竣工を予定)
 ※新拠点で事業展開する事業については、半導体マテリアル製品、装置部品洗浄を予定



熊本新拠点完成予想図

浙江省常山

第二期工場：量産拡大中

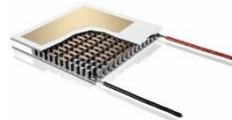
第三期工場：23年内に竣工開始



石英



金属加工



サーモジュール



セラミックス



シリコンパーツ



CVD-SiC

四川省内江

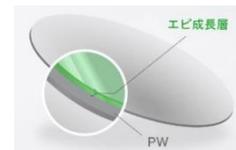
23年7月竣工予定

浙江省麗水

22年竣工済み



パワー半導体基板



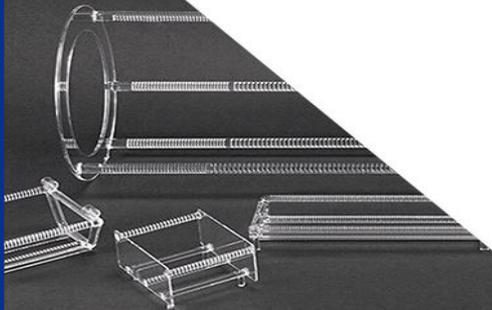
Siウェーハエピ



Ferrotec
Ferrotec Holdings Corporation



経営基盤の強化
(デジタル化、人材投資等)



- 中国生産拠点でERP、MESを始め、様々なシステム導入が進み、生産の見える化、効率化、品質の向上が実現(AI活用、ロボットの積極導入)
⇒ 日本、マレーシア新拠点でも自動化投資を積極化(水平展開を進める)



自動搬送システム



自動倉庫システム



自動検査装置

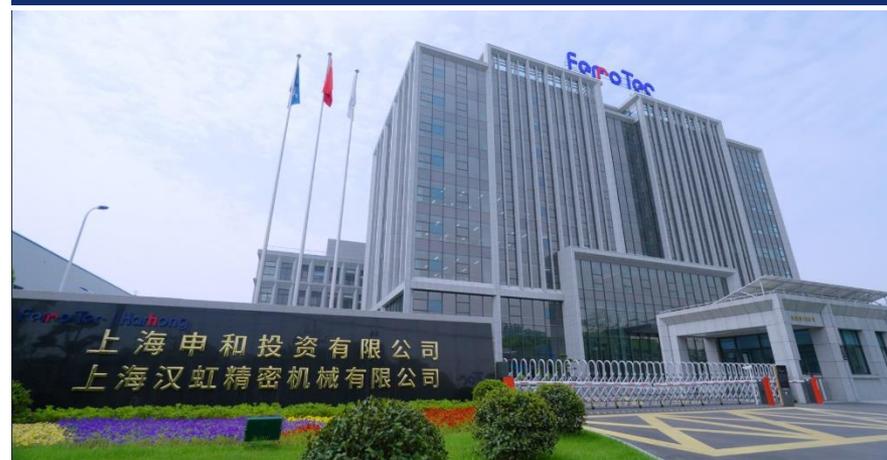
モノづくりにおけるDX化を推進し、生産性及び品質の向上に取り組む

- ◆日本、中国、マレーシアなど、事業拡大を進めるエリアでのブランディングを強化し、優秀な人材の確保を押し進める。
- ◆グループ内で2023年を「学びの年」と位置付け、「常に最新の技術や知識を学び、技術革新や新製品の創出に取り組める」企業文化の構築に取り組む

日本: 石川・熊本などの事業拡大エリアを中心に6月以降ブランディングを強化し、優秀な人材確保を進める(TVCM放映、駅サインエージ広告他、グループ知名度の向上を図る)



中国: 上海に中国本部機能を統合するため、新ビルを建設。上海での研究開発人員採用、および中国内ブランディングを強化 ※中国内の大学、研究機関との関係を強化し優秀な人材を確保



【2022年5月30日開示内容】

配当政策

持続的な収益増強により株主還元を増加させていく基本方針は不変だが、配当の決定に際して、「配当性向20%」を意識して、財務・投資機会等とのバランスを考慮して判断する

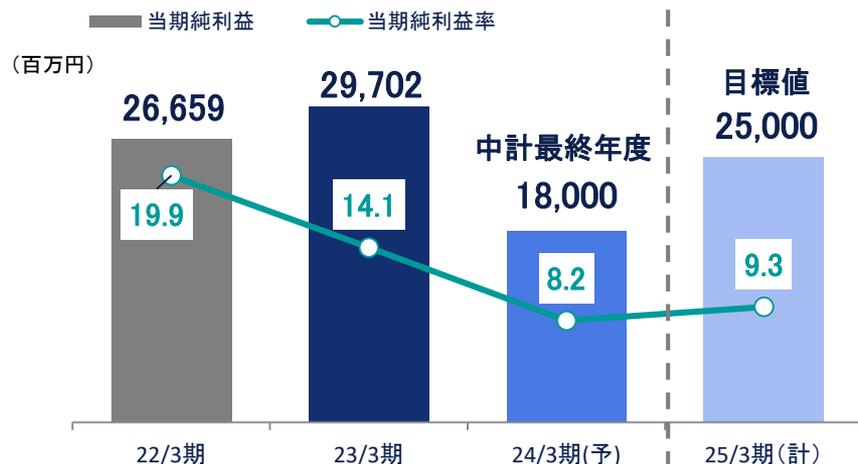
【2023年3月期】

<期初>

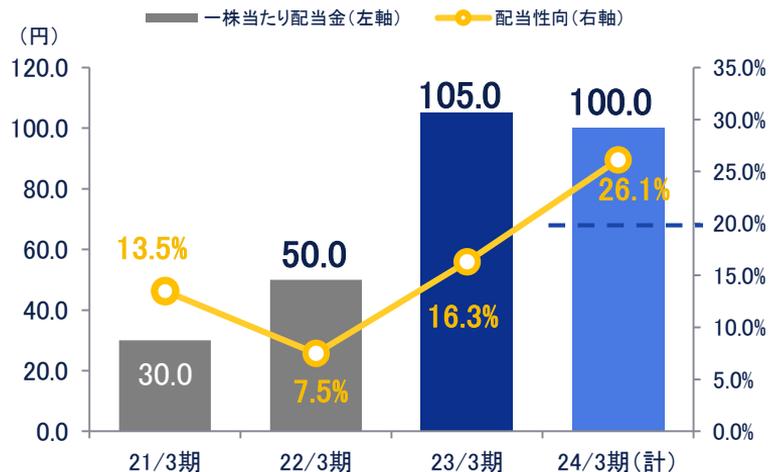
<今回>

・1株配当：70円/年 ⇒ 105円/年
 【配当総額】 (32億円) ⇒ (49億円)
 【純利益】 (170億円) ⇒ (297億円)

当期純利益の目標値



配当金の目標値



長期目標は前回どおり売上高5,000億円で変わらず

長期業績目標は継続

2030年度に売上高**5,000**億円 当期純利益**500**億円の達成を目指す！

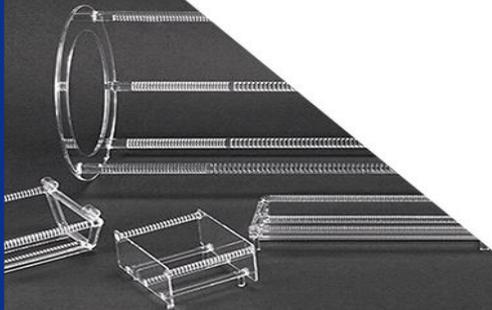




Ferrotec
Ferrotec Holdings Corporation



Appendix



半導体製造装置向け治具・消耗材(当社主力のマテリアル製品群)



石英



シリコンパーツ



セラミックス



CVD-SiC

当社製品群の強み: 設備投資連動型(真空シール)のみでなく、**半導体デバイスメーカーの生産稼働連動型リピート消耗材(マテリアル製品)**、サービス(洗浄・再生ウェーハ)をラインアップ



真空シール

※半導体・FPD
製造装置部品
(市場占有率:65%(TOP))



金属精密加工

※今後の中国国内顧客
(工場)増で伸長の見通し



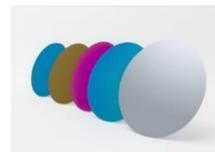
装置部品洗浄

※中国市場に特化



石英坩堝

※半導体・太陽電池向け



再生ウェーハ

※中国市場に特化
(22/3期~新規事業)

持分法適用関連会社での事業



シリコンウェーハ

※月産能力6インチ 42万枚、8インチ 45万枚
12インチ3万枚(今後→10万枚→20万枚へ)



SiCウェーハ

※開発~量産化
(22/3期~新規事業)

サーモジュール



※自動車・半導体製造装置・通信・医療バイオ・民生品など、温度調整デバイスとして用途が拡大中
(市場占有率:36%(TOP))



PCR検査用途の増加
DNA増幅を活用し、顕微鏡では見ることのできない病原体の有無を検査する際に必要

パワー半導体用絶縁基板



※世界の消費電力削減のトレンドに対応し、パワー半導体顧客からの需要が拡大中(アルミナセラミックス基板に銅回路を接合する DIRECT COPPER BONDING技術)

パワー半導体のアプリケーション



磁性流体



※自動車スピーカーや、高音質TVスピーカー、スマホのバイブレーション向けへの用途が拡大中
(市場占有率:80%(TOP))

温度センサ(サーミスタ) ※大泉製作所



※サーミスタは温度変化に対し、極めて大きな抵抗変化を示す半導体セラミックス。車載・家電・光通信などの温度センサとして幅広く使用され、車両電動化やデジタル化で需要拡大中

フェロテックグループの中国での生産拠点マップ

中国内における当社工場分布



中国半導体企業主要拠点の近くに生産拠点を配置し、顧客の満足度向上に取り組むことで、国産化を前提とした市場成長に貢献し、同時に事業拡大を実現する

- | | |
|------------|------------------------|
| 石英 | サーマモジュール |
| シリコンパーツ | パワー半導体基板 |
| セラミックス | 半導体ウエーハ |
| CVD-SiC | SiCウエーハ |
| 部品洗浄 | 赤字は中国半導体企業的主要拠点 |
| 真空シール・金属加工 | ①北京 ②上海 |
| 再生ウエーハ | ③武漢 ④合肥 |
| | ⑤西安 |

- 本資料に掲載されている将来見通しの記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因の仮定を前提としております。
- 実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる可能性があります。業績に影響を与える要素には、国際情勢、経済情勢、製品の需給動向、原材料価額及び市況、為替レートなどが含まれますが、これに限定されるものではありません。
- 本資料中の定量目標などは、あくまで中長期的な戦略、ビジョン等を示すものであり業績予想ではありません。当社はこれらについて情報を更新する義務を負いません。
- 正式な業績予想は、東京証券取引所規則に基づく決算短信での開示をご参照ください。

<本件照会先>

IR室 03-3281-8186